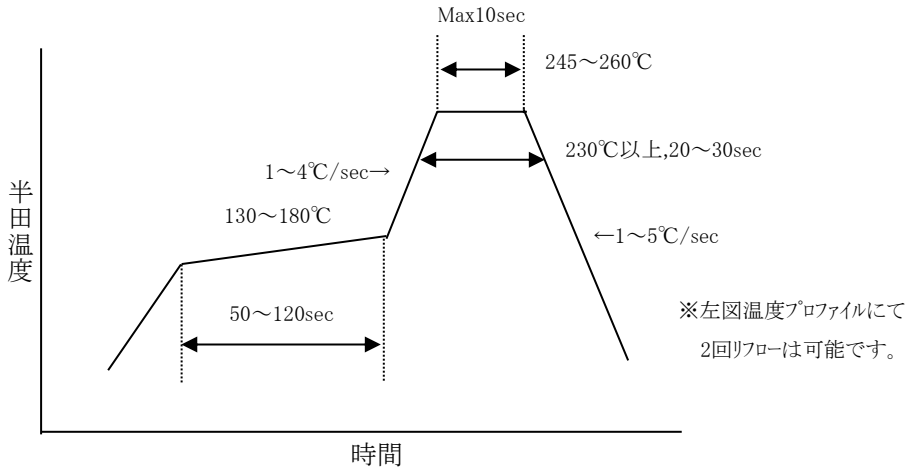


## 【半田リフロー条件】

SC-59,SC-74,SC-70,SC-75A,USM6F,SC-88,SC-88A,SOT-89,SC-63,TMSOP8,SOP8,  
SOP14,SSOP14パッケージ

(TO-92Sパッケージ製品においての、リフロー実施は対象外となっています。)



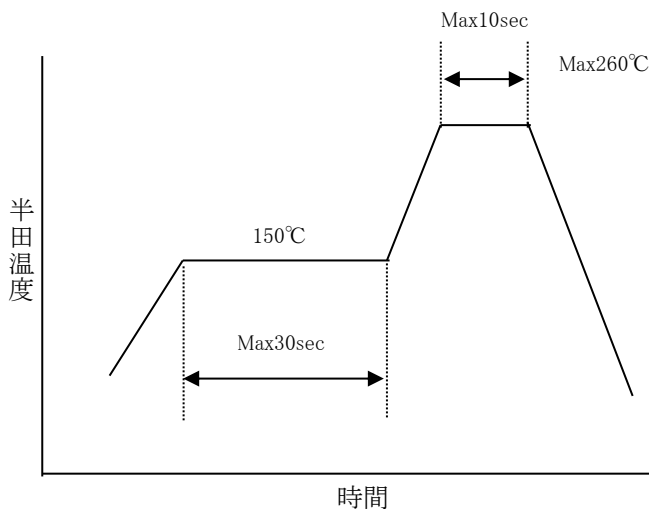
赤外線リフロー時の樹脂表面部の温度プロフィール(リフロー後、基板の強制冷却は避けてください。)

半田濡れ性を確保するため、ピーク温度245°C以上であることを推奨致します。

## 【半田フロー条件】

SC-59,SC-74,SC-70,SC-75A,SC-88,SC-88A,SOT-89,SC-63,TO-92Sパッケージ

(USM6Fパッケージ製品においての、フロー実施は対象外となっています。)



※リード品:リード部だけの浸漬とします。

※左図温度プロフィールにて  
2回フローは可能です。

基板上に接着剤で固定して、融解半田に浸漬する方法ですが、定融点半田仕様の場合、半田温度 260°C 浸漬時間 10sec が適切と思われます。また基板サイズが大きい場合、熱容量の関係で上記条件では充分温度が上がらないことが予想されますので、150°C程度で20~30secの予備加熱をして下さい。

半田濡れ性を確保するため、ピーク温度245°C以上であることを推奨致します。

## 【手半田付け条件】

こて先温度380°C以下、3秒以内で温度・時間に充分注意してご使用下さい。